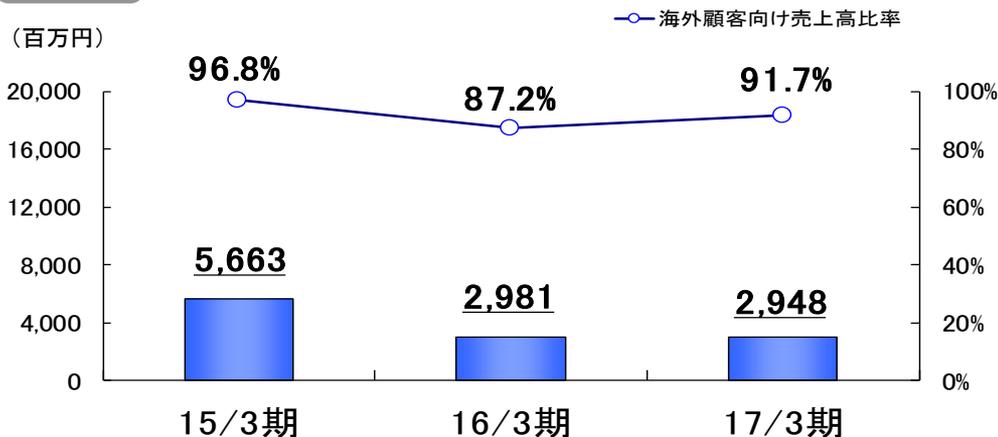


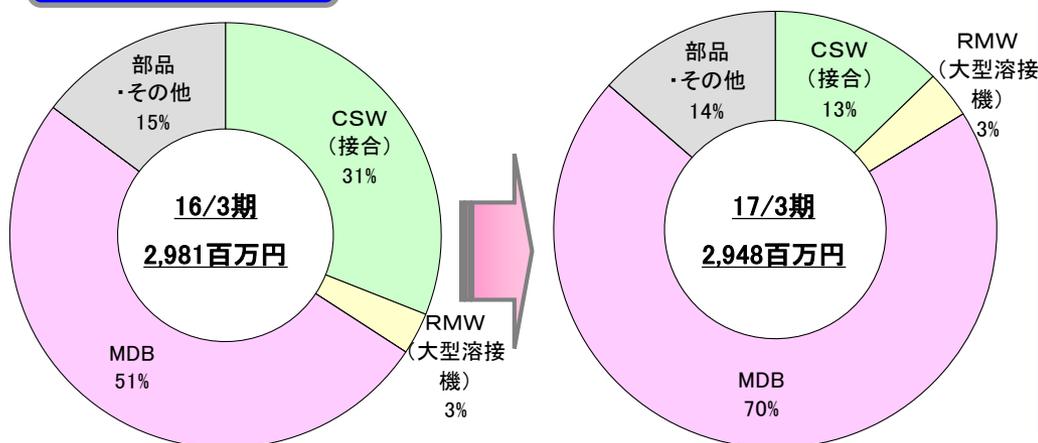
# メカトロニクス事業

# 1. 概況

## 売上高



## 市場別売上高比率



## ◆POINT◆

### ◇17/3期 決算概要

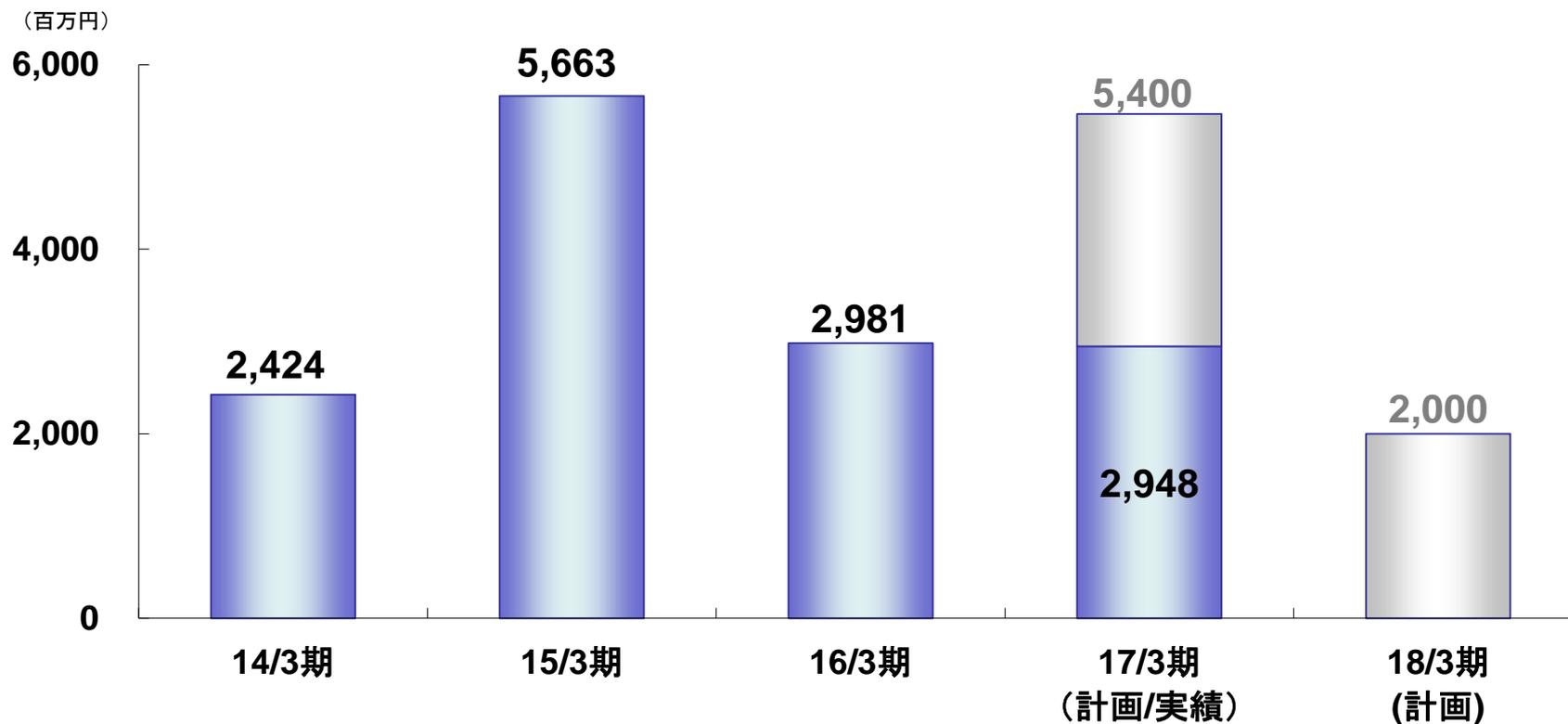
売上高は前期比1.1%減の29億4千8百万円(総売上高の9.4%)となりました。MDBは大型案件により前期に比べ伸長したものの、光通信関連市場(接合)は前期の中国における市場停滞の影響が大きく、売上げを伸ばすことが出来ませんでした。

### ◇18/3期 計画概要

- ・MDBは中国市場への拡販を継続
- ・大型溶接機は自動車部品向け新規顧客拡販
- ・接合は光半導体用小型自動溶接機の高付加価値製品対応強化による市場確保
- ・真空ソルダは新モデルによるパワー半導体/LED市場への拡販  
＝大型量産機MP2・小型生産機VS1

通期売上高計画20億円

## 2. 売上高の推移



### 17/3期計画と実績の差異要因

- ・MDBは前期比にて売上を約30%伸ばすことができたものの、中国ローカルメーカーへの量産装置の拡販を計画通りに進めることができませんでした。
- ・小型溶接機は光半導体の中国における市場停滞と、競合他社の影響もあり、計画から大きく落ち込む結果となりました。

# 3. 主要製品群(4本の柱)

## 重点製品とターゲット市場

### 1. 【MDB】(Mobile Display Bonder)

モバイルディスプレイ用貼合せ装置

*オフライン装置拡販を  
軸に市場確保!*

→中国ローカル市場



### 3. 【CSW】(Cap Seal Welder)

光半導体用小型溶接機

*高付加価値製品へ  
の対応!*

→アジア光通信市場



### 2. 【RMW】(Ring Mash Welder)

自動車部品用大型溶接機

→国内・海外  
自動車関連市場



### 4. 【VSM】(Vacuum Soldering Machine)

真空ソルダリングシステム

改良版投入!

→国内・アジア  
パワー半導体市場  
LED市場

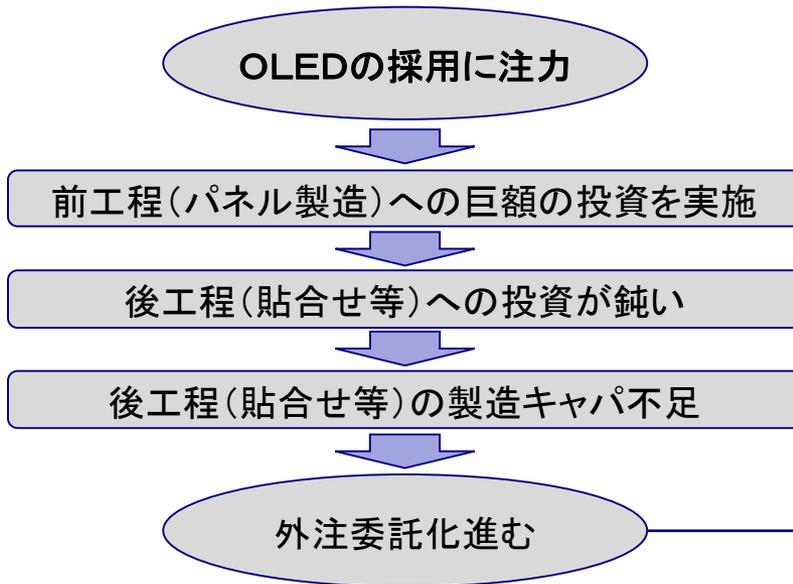


# 4-1. 18/3期 売上高減少の要因

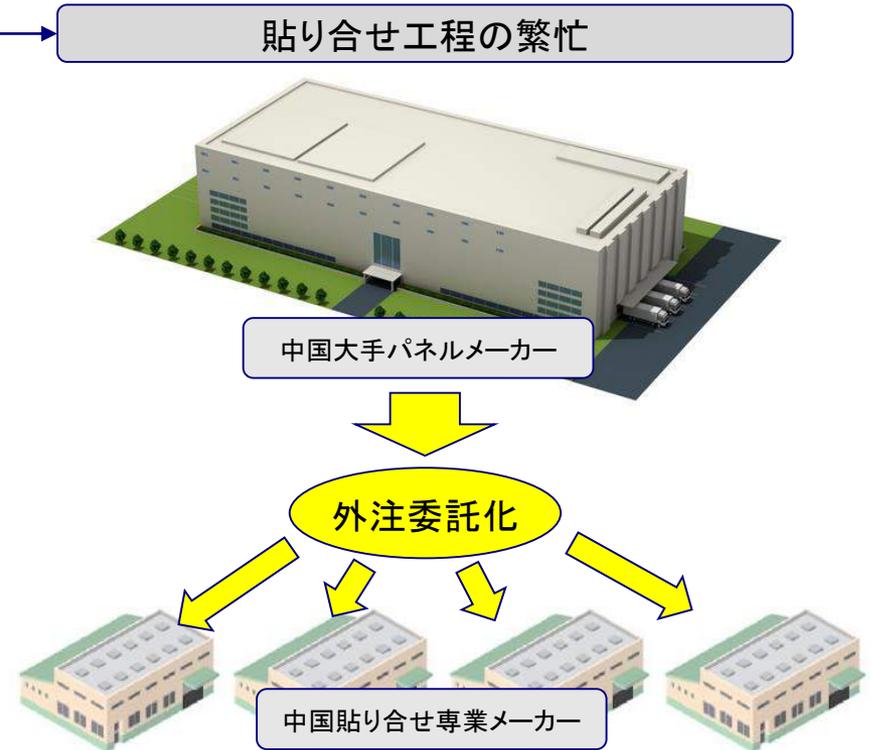
MDBが前期比大幅減

中国大手パネルメーカーは有機EL(OLED)に向けた前工程(パネル製造)への投資を先行させ、後工程(貼合せ等)への投資は鈍いと予測

## 中国大手パネルメーカーの動向



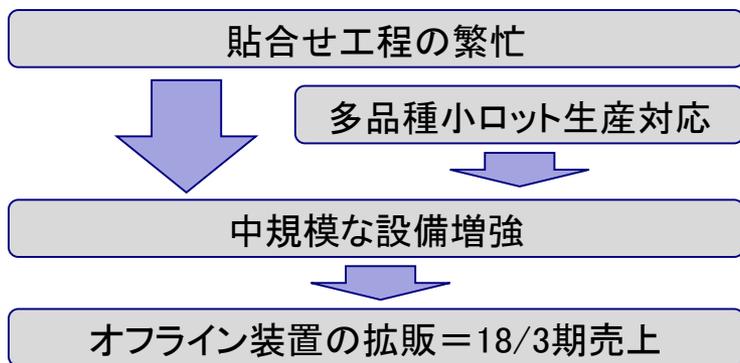
## 中国貼合せ専門メーカーの動向



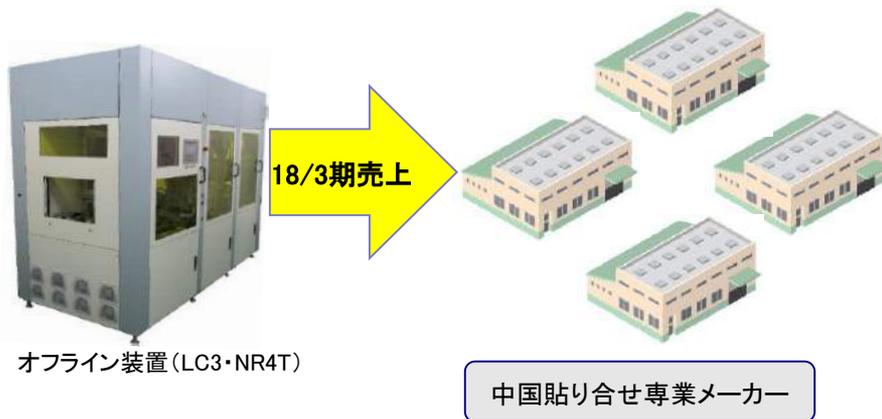
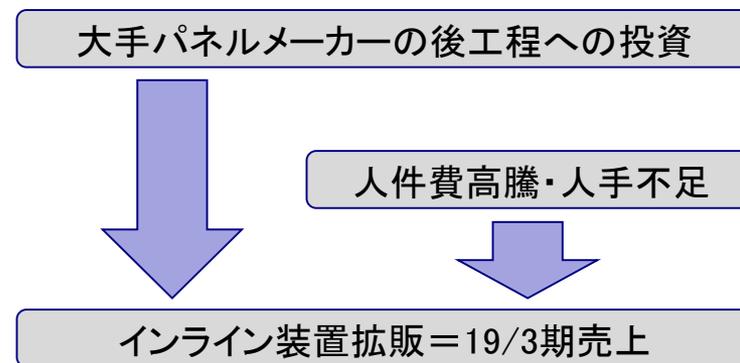
# 4-2. 18/3期 MDB取組み

- ① 中国貼合せ専門メーカーへのオフライン装置拡販により市場確保
- ② 下期に大手パネルメーカー向けインライン装置受注／19/3期売上

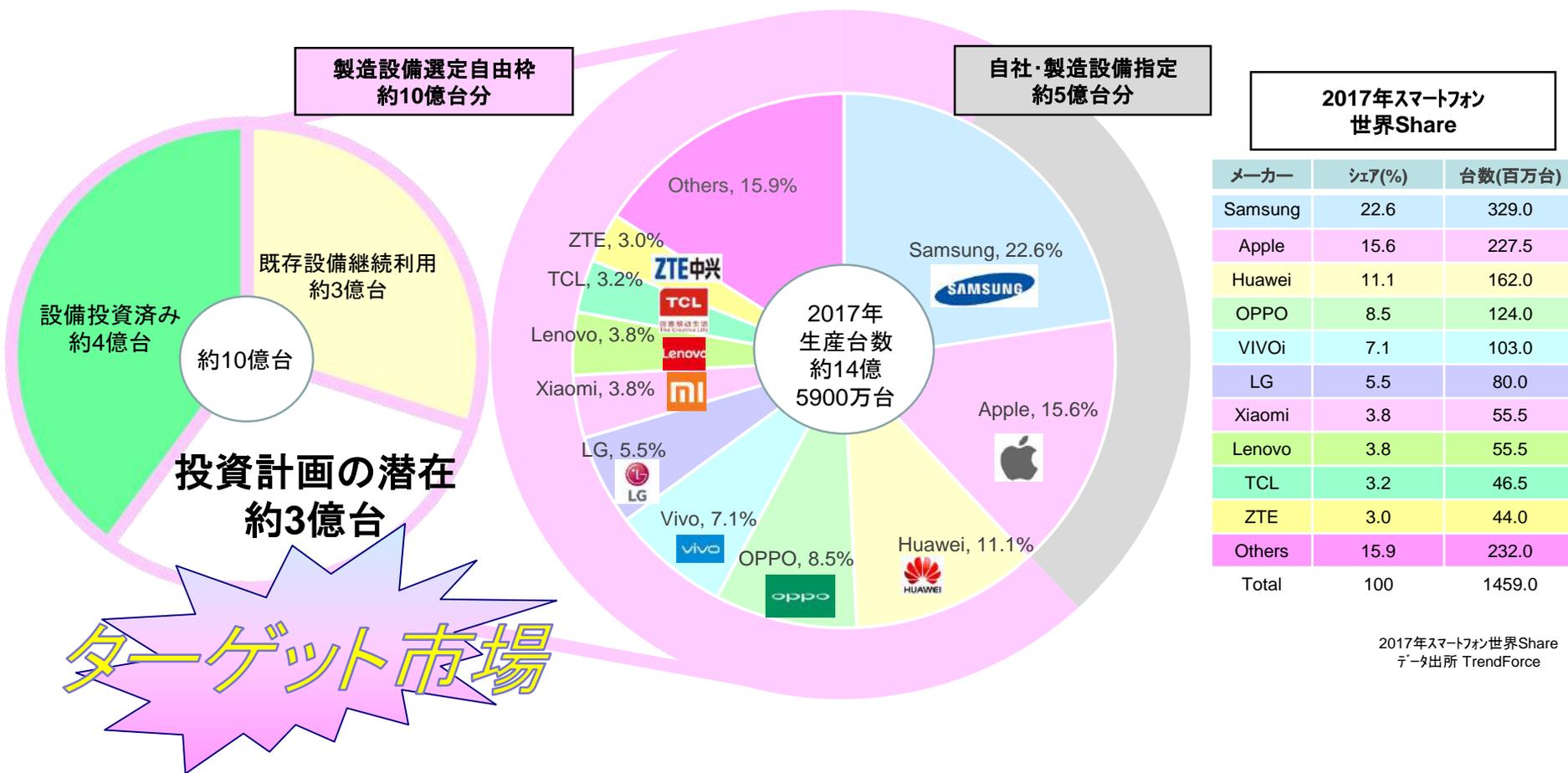
## ①中国貼合せ専門メーカーへの取組み



## ②中国パネルメーカーへの取組み



# 4-3. MDB市場ターゲット



2017年スマートフォン世界Share  
データ出所 TrendForce

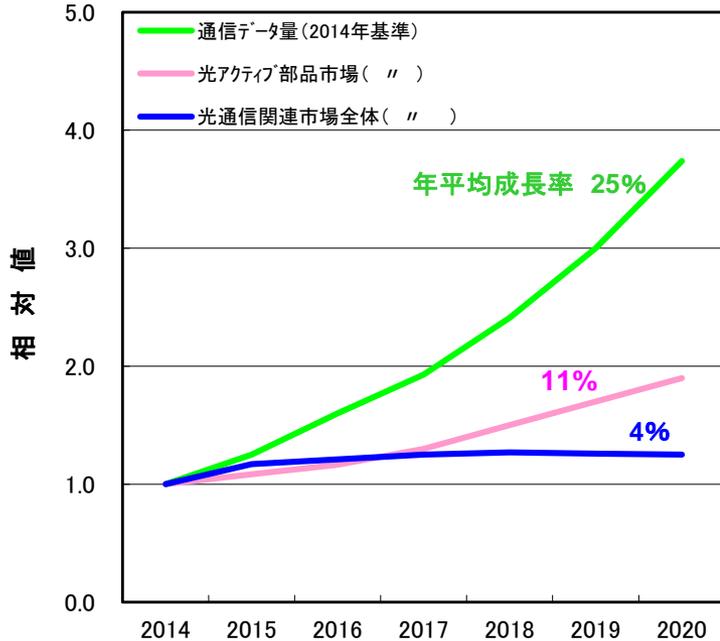
# 5. CSW(光半導体用小型溶接機)

## 光通信関連市場向け

多様化する顧客製品対応に  
新機能を投入

高付加価値製品対応

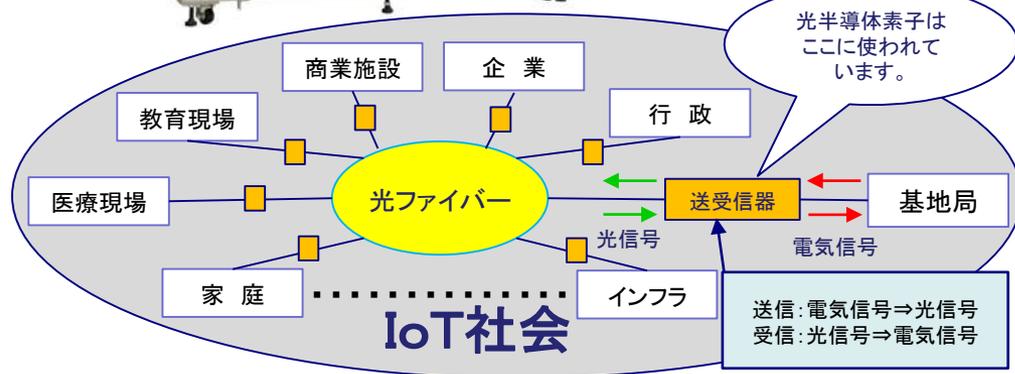
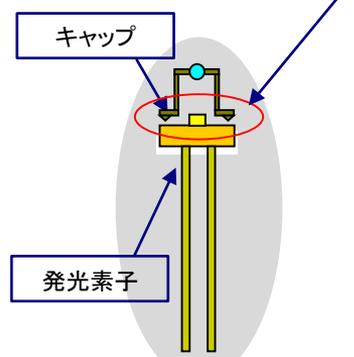
通信データ量と光通信市場の将来予測



・通信データ量: 米シスコシステムズによる予測  
 ・光通信関連市場全体・光アクティブ部品市場:  
 「2015光通信関連市場総調査」富士キメラ総研



キャップと発光素子を接合



# 生産・販売拠点

